

高导热氮化铝陶瓷基板 产品说明书

产品类别：氮化铝陶瓷 / 氮化铝基板

产品简介

氮化铝（AlN）陶瓷基板导热系数是氧化铝的7倍以上，热膨胀系数与硅接近，是大功率器件理想的散热封装基板。采用流延成型与无压烧结工艺，平整度高、介电性能优良，支持镀膜（镀镍/镀银/化学镍金）与激光划片等后道加工。

产品特点

· 导热 170+ W/mK · 与硅片热膨胀匹配 · 高绝缘

技术参数

参数名称	典型数值
导热系数	$\geq 170 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
密度	$\geq 3.30 \text{ g/cm}^3$
抗弯强度	$\geq 400 \text{ MPa}$
体积电阻率	$\geq 10^1 \quad \Omega \cdot \text{cm}$
热膨胀系数	$4.5 \times 10 \quad / \text{K (20-400)}$
使用温度	$\leq 1000 \quad (\text{惰性气氛})$

适用行业 / 应用场景

IGBT功率模块、激光器封装、高频器件、新能源汽车电控

联系我们

公司名称	中纳新材料科技有限公司
联系电话	0512-6688 8888
电子邮箱	sales@zhongna-materials.com
公司地址	江苏省苏州市工业园区新材料产业园88号

注：本说明书所载参数为典型值，仅供选型参考，具体以双方签订的合同及技术协议为准。© 中纳新材料科技有限公司